

<<电子产品组装工艺与设备>>

图书基本信息

书名：<<电子产品组装工艺与设备>>

13位ISBN编号：9787115164377

10位ISBN编号：7115164371

出版时间：2007-9

出版时间：人民邮电出版社

作者：杨清学 主编

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子产品组装工艺与设备>>

### 内容概要

本书主要内容包括常用电子元器件、电路图的识读与常用工艺文件、印制电路板、常用装配工具与准备工艺、常用设备、焊接技术、常用电子测量仪器及电子产品的总装与检验。

本书中包含9个实训内容，使学生在理论学习的同时，能够进行实际操作。

本书可作为高职高专院校电子类专业的教材，也可作为广大电子爱好者的自学参考书。

## &lt;&lt;电子产品组装工艺与设备&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 常用电子元器件	1.1 电阻器	1.2 电位器	1.3 电容器	1.4 电感线圈	1.5 变压器	1.6 晶体二极管	1.7 晶体三极管	1.8 场效应管	1.9 可控硅	1.10 集成电路	1.11 电声器件	1.12 开关、继电器、各种接插件	1.13 表面安装元器件	1.14 光电器件	1.15 显示器件	本章小结	习题1
第2章 电路图的识读与常用工艺文件	1.1 电路图识读的基本知识	1.2 电路原理图的识读	1.3 印制电路图的识读	1.4 常用工艺文件	本章小结	习题2	第3章 印制电路板	3.1 覆铜板的种类与选用	3.2 印制电路板的特点和分类	3.3 印制电路板的手工制作	3.4 印制电路板生产工艺	本章小结	习题3				
第4章 常用装配工具与准备工艺	4.1 常用装配工具	4.2 准备工艺	本章小结	习题4													
第5章 常用设备	5.1 浸锡炉	5.2 波峰焊接机	5.3 再流焊接机	5.4 贴片机	本章小结	习题5											
第6章 焊接技术	6.1 焊接材料	6.2 手工焊接技术	6.3 实用焊接技术	6.4 焊接质量的检查	6.5 拆焊	6.6 自动焊接技术	6.7 表面安装技术与工艺	6.8 紧固件连接、胶接、无锡焊接工艺	本章小结	习题6							
第7章 常用电子测量仪器	7.1 万用表	7.2 毫伏表	7.3 信号发生器	7.4 示波器	7.5 频率特性测试仪	本章小结	习题7										
第8章 电子产品的总装与检验	8.1 电子整机总装工艺	8.2 电子整机调试工艺	8.3 电子整机产品的质量管理	8.4 电子整机产品检验	8.5 电子产品包装工艺	本章小结	习题8										

<<电子产品组装工艺与设备>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>